

# SID

Werk: Rot am See

Artikel:

689

ML10

Erstellt:

Stockburger, Olesja

Kunde:

Datum:

26.01.2016



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		2
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		3
		70	L2	
C-RS-FR4-ML-0.10mm-070+070-TG150-HF	50200773	100		4
		70	L3	
				A01
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	160		5
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6
		70	L4	
C-RS-FR4-ML-0.10mm-070+070-TG150-HF	50200773	100		7
		70	L5	
				A02
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	160		8
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		9
		70	L6	
C-RS-FR4-ML-0.10mm-070+070-TG150-HF	50200773	100		10
		70	L7	
				A03
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	160		11
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		12
		70	L8	
C-RS-FR4-ML-0.10mm-070+070-TG150-HF	50200773	100		13
		70	L9	
				A04
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	195		14
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		15
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	16

B00

Dicke nach Verpressen

B00:

1890 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2090 µm

Dmin:

1690 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

2000 µm

Tol+:

200 µm

Tol-:

200 µm

Dmax:

2200 µm

Dmin:

1800 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1900 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik